



(11)

EP 2 436 057 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(48) Corrigendum ausgegeben am:
27.11.2013 Patentblatt 2013/48

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
02.10.2013 Patentblatt 2013/40

(21) Anmeldenummer: **10722096.4**

(22) Anmeldetag: **28.05.2010**

(51) Int Cl.:
H01L 51/10 (2006.01) **H01L 51/44 (2006.01)**
H01L 51/52 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2010/057482

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2010/136591 (02.12.2010 Gazette 2010/48)

(54) ELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING AN ELECTRONIC COMPONENT
 COMPOSANT ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
 GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
 PL PT RO SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **29.05.2009 DE 102009023350**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.04.2012 Patentblatt 2012/14

(73) Patentinhaber:

- **OSRAM Opto Semiconductors GmbH**
93055 Regensburg (DE)
 Benannte Vertragsstaaten:
**AL BG CY CZ DE DK EE ES FR GB GR HR HU IE
 IS IT LT LU LV MC MK MT NO PL PT RO SI SK SM
 TR**
- **Siemens Aktiengesellschaft**
80333 München (DE)

(72) Erfinder:

- **SCHMID, Günther**
91334 Hemhofen (DE)
- **HUNZE, Arvid**
91056 Erlangen (DE)

(74) Vertreter: **Epping - Hermann - Fischer**
Patentanwaltsgeellschaft mbH
Ridlerstrasse 55
80339 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
US-A1- 2007 273 280 **US-A1- 2008 163 926**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingegangen, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).